

LAMPIRAN III DOKUMENTASI

III.1 Penyiapan Bahan Baku



Gambar 1. Singkong Setelah di Kupas



Gambar 2. Singkong di Rajang berbentuk *Chip*



Gambar 3. Singkong di Timbang

III.2 Fermentasi



Gambar 4. Bahan Baku (Singkong /*Chip*, Starter BAL dan Air) dimasukkan ke dalam Fermentor *Mocaf* dan di Fermentasi



Gambar 5. Pengecekan pH dan Temperatur Selama Fermentasi



Gambar 6. *Chip* di Tiriskan dan Timbang Setelah Fermentasi

III.3 Pengeringan



Gambar 7. Chip hasil fermentasi dikeringkan di *rotary dryer*



Gambar 8. Chip hasil pengeringan

III.4 Penggilingan



Gambar 9. Chip hasil pengeringan, digiling di *diskmil*



Gambar 10. Tepung hasil penggilingan

III.5 Screening/pengayakan



Gambar 11. Tepung diayak di *vibrating screen*



Gambar 12. *screen* yang digunakan berukuran 60, 80, 100 *mesh*



(a)

(b)

Gambar 13. (a) Hasil pengayakan tepung, (b) *Undersize* dan *oversize*

III.6 Uji Kadar Air



(a)

(b)

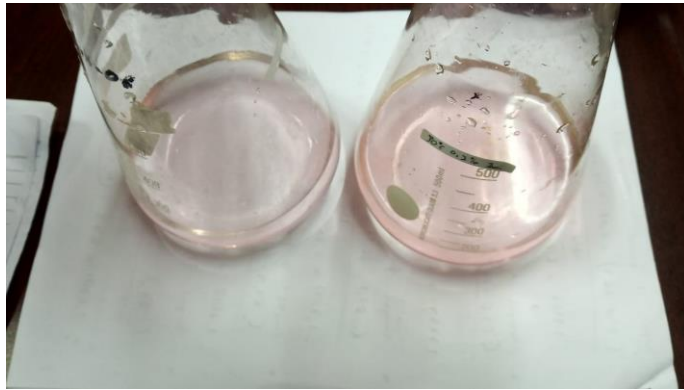
(c)

Gambar 15. Uji Kadar Air (a) Sampel & Cawan di Timbang, (b) Sampel di Keringkan, dan (c) Didinginkan di Desikator

III.7 Uji Kadar Protein



Gambar 16. Proses Destruksi



Gambar 17. Hasil Titrasi

III.8 Tepung MOCAF



Gambar 18. Tepung *Mocaf*